



平成 28 年 8 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社岡本工作機械製作所
代表者名 代表取締役社長 石井 常路
(コード番号 6125、 東証 第2部)
問合せ先 執行役員総務部長 石川 清和
(TEL. 027-385-5800)

「研究成果最適展開支援プログラム」採択について

当社半導体関連装置開発部門は、国立研究開発法人科学技術振興機構が行っている「研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)」(以下当該事業)における「ステージⅢ (NexTEP-A タイプ)」の新規課題に応募し、このたび採択されましたので、お知らせいたします。

記

1. 「研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)」の目的

当該事業は、大学・公的研究機関等で生まれた国民経済上重要な科学技術に関する研究成果を基に、実用化を目指す研究開発フェーズを対象とした技術移転支援プログラムです。

2. 採択された事業

(1) 事業テーマ名

「Si 貫通電極ウェーハ全自動薄化加工装置」

(2) 事業の概要

本事業テーマは Si 貫通電極(TSV)ウェーハを高平坦かつ高均一に 10 μ m 厚さレベルまで薄層化する加工技術です。新たに開発した自動 Si 厚さ補正機構付き研削盤、Si/Cu 同時研削技術、および金属汚染低減化技術を融合した TSV ウェーハ全自動薄化加工装置を世界で初めて実用化します。

(3) 事業支援期間

事業支援予定期間：2016 年 10 月～2020 年 9 月迄

(4)支援金額等について

支援金額は、支援事業の実績を報告し、審査を経て確定します。その為、現時点で確定した金額および受け取り時期は未定であります。

3.今後の見通し

今後の業績に与える影響は精査中であり、開示が必要な場合には、改めてお知らせ致します。

以上